

股票简称：中芯国际

股票代码：688981



Semiconductor Manufacturing International Corporation

中芯国际集成电路制造有限公司

(Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111 Cayman Islands)

首次公开发行股票科创板 上市公告书

联席保荐机构（主承销商）



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

上海市黄浦区广东路 689 号



CICC
中金公司

北京市朝阳区建国门外大街 1 号
国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

联席主承销商



国泰君安证券股份有限公司
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.

中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号



国开证券
CHINA DEVELOPMENT BANK SECURITIES

北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.

北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

摩根士丹利华鑫证券

MORGAN STANLEY HUAXIN SECURITIES

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道
100 号上海环球金融中心 75 楼 75T30 室

二〇二〇年七月十五日

特别提示

中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“中芯国际”、“发行人”、“本公司”或“公司”）股票将于 2020 年 7 月 16 日在上海证券交易所科创板上市。

本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

第一节 重要声明与提示

一、重要声明

本公司及全体董事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

二、风险提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，提醒投资者充分了解交易风险、理性参与新股交易，具体如下：

（一）涨跌幅限制放宽

上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板，在企业上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。

科创板企业上市后前 5 个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市 5 个交易日后，涨跌幅限制比例为 20%。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板更加剧烈的风险。

（二）A 股流通股数量较少

上市初期，保荐机构跟投股份锁定期为 24 个月，其他战略投资者锁定期为 12 个月，网下限售股锁定期为 6 个月。本次发行后¹，本公司 A 股的无限售流通股为 1,040,231,223 股，分别占发行后已发行股份总数的 14.58%（行使超额配售选择权之前）、14.08%（全额行使超额配售选择权之后），公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（三）市盈率高于同行业水平

本公司所处行业为专用计算机、通信和其他电子设备制造业（C39），本次发行价格 27.46 元/股，对应本公司 2019 年度扣除非经常性损益前²的摊薄后市盈率（全额行使超额配售选择权之后）为 113.12 倍，高于截至 2020 年 7 月 4 日（T-3 日）中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率 46.17 倍，本公司提醒投资者注意未来可能存在股价下跌带来损失的风险。

（四）股票上市首日即可作为融资融券标的

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

三、特别风险提示

¹ 本次发行前后股份总数均以 2020 年 5 月 31 日为基准计算

² 发行人 2019 年度扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润为-52,209.54 万元，故不适用扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润对应的市盈率指标

（一）目前公司 14 纳米及 28 纳米制程产品收入占比较低，28 纳米制程产品产能过剩、收入持续下降、毛利率为负的风险

报告期各期，公司 28 纳米制程产品收入分为 163,397.35 万元、124,522.10 万元及 80,685.76 万元，占比分别为 8.12%、6.19%及 4.03%，收入及占比持续下降；公司于 2019 年第四季度开始量产 14 纳米制程产品，相关收入为 5,706.15 万元，占比为 0.29%。此外，由于 28 纳米制程相关的产线仍面临较高的折旧压力，报告期内公司 28 纳米产品毛利率为负。

同时，由于目前 28 纳米全球纯晶圆代工厂商的产能布局较多，造成全球 28 纳米市场产能过剩。公司出于市场经营策略和客户需求考虑，在满足订单需求的前提下，优化产品组合，将部分原用于 28 纳米制程的通用设备转用于生产盈利较高的其他制程产品。

未来，如果 28 纳米和 14 纳米相关客户需求未能快速提升，公司面临 28 纳米制程产品产能过剩、收入持续下降，14 纳米及 28 纳米制程产品收入占比较低、毛利率为负的风险。

（二）扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润持续为负的风险

报告期内，由于先进和成熟工艺生产线的扩产尚未体现规模效应，公司面临较高的折旧压力，且研发投入不断增大，使得公司 2018 年、2019 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为负，分别为-61,685.35 万元、-52,209.54 万元。

集成电路晶圆代工行业是资本密集型行业，新产线投产后会在短期内面临较高的折旧负担，且部分新工艺平台升级带来的销售收入增长具有一定的滞后性，对晶圆代工企业的盈利水平产生一定影响。

未来，如果客户需求增长缓慢，公司产能利用率无法提升，折旧大幅增加，或者研发投入未能及时形成收入的增加，公司可能面临扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润持续为负的风险。

（三）公司未来一定时期内折旧费用进一步增加的风险

截至报告期末，公司合计在建工程账面价值为 1,705,966.79 万元，占资产总额的比例为 14.86%，上述在建工程将在达到预定可使用状态时转入固定资产并开始计提折旧。此外，公司未来将继续在成熟和先进制程领域进行产能扩张，亦会在一定时期内增加在建工程金额。随着在建工程项目陆续达到预定可使用状态，并转入固定资产，公司在一定时期内面临折旧费用进一步增加的风险。

此外，中芯南方在建工程账面价值为 1,054,065.31 万元，预计 2020 年下半年开始陆续转入固定资产，一定时期内可能面临较大折旧压力，导致中芯南方扣非后净利润下滑，甚至出现扣非后净利润产生大额亏损的风险，可能会对公司整体扣非后归母净利润产生较大影响。

（四）公司研发与生产需持续投入巨额资金的风险

集成电路晶圆代工行业属于资本密集型行业。为持续追赶世界先进工艺，不断升级现有工艺技术平台以保持市场竞争优势，并保证充足的产能以满足订单生产需求，提高核心竞争力，公司需要持续进行巨额的资金投入。

报告期各期，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为 1,584,443.86 万元、1,160,292.93 万元及 1,272,275.49 万元；研发投入分别为 357,607.78 万元、447,090.01 万元及 474,445.66 万元。

未来，如果公司不能获取足够的经营收益，或者融资受限，导致资金投入减少，可能对公司的竞争优势产生不利影响。

（五）晶圆代工市场竞争激烈，公司与行业龙头相比技术差距较大、目前市场占有率较低的风险

随着 5G、物联网、人工智能和云计算等新应用领域的不断涌现，芯片产业发展的热点领域在不断丰富，广阔的市场前景及较为有利的产业政策吸引了诸多境内外集成电路相关企业布局集成电路晶圆代工行业，可能将导致市场竞争进一步加剧。

根据公开信息整理，行业龙头分别于 2015 年、2016 年及 2018 年实现了 16 纳米、10 纳米及 7 纳米制程的量产，中芯国际 14 纳米制程的量产时间为 2019 年；根据 IC Insights 统计，2018 年度行业龙头占全球纯晶圆代工市场份额的 59%，中芯国际占 6%。

如果公司无法及时开发和引进最新的制造工艺技术，或推出能够更好地满足客户需求的工艺平台，将削弱公司的竞争优势，并对公司的经营业绩产生不利影响。

（六）晶圆代工领域技术升级迭代风险

集成电路丰富的终端应用场景决定了各细分领域芯片产品的主流技术节点与工艺存在差异，且技术迭代与相应市场需求变化较快。

先进工艺一般一到三年往前推进一代，如行业龙头 2015 年量产 16 纳米/14 纳米，2016 年量产 10 纳米，2018 年量产 7 纳米，2020 年量产 5 纳米。若晶圆代工厂商技术迭代大幅落后于产品应用的工艺要求，则无法满足市场和客户的需求。

公司目前已实现 14 纳米量产，下一代工艺已进入客户导入阶段，但相较于行业龙头已量产更先进制程的现状，公司在工艺制程上与行业龙头公司仍存在一定差距。

在行业技术快速迭代的背景下，如公司在先进制程领域不能及时根据市场需求实现更先进节点的量产，或在成熟制程领域不能及时根据市场需求开发相应的特色工艺平台，均有可能使得公司错失相应的市场空间，进而对公司的竞争力与持续盈利能力产生影响。

（七）公司子公司较多带来的管理控制风险

截至 2019 年 12 月 31 日，公司共有子公司 37 家，其中境内子公司 17 家，境外子公司 20 家，分布在多个国家和地区。未来，若子公司发生经营、合规、税务等方面风险，可能对公司的经营业绩造成相关不利影响。

此外，公司的控股子公司中芯北方、中芯南方均为中外合资企业，中芯北方

和中芯南方分红等事项需全体董事的三分之二以上批准；同时，中芯南方的分红等事项还需取得其他股东委派董事的同意。因此，公司无法单方面决定中芯北方和中芯南方分红等重大事项。

公司存在因子公司较多带来的管理控制风险。

（八）美国出口管制政策调整的风险

目前，经济全球化遭遇波折，多边主义受到冲击，国际金融市场震荡，特别是中美经贸摩擦给一些企业的生产经营、市场预期带来不利影响。

公司坚持国际化运营，自觉遵守生产经营活动所涉及相关国家和地区的法律、法规，自成立以来合规运营，依法开展生产经营活动。

2019年5月，美国商务部将若干中国公司列入“实体名单”；2020年5月，美国商务部修订直接产品规则（Foreign-Produced Direct Product Rule），据此修订后的规则，若干自美国进口的半导体设备与技术，在获得美国商务部行政许可之前，可能无法用于为若干客户的产品进行生产制造。

上述修订的规则中，仍然有许多不确定的法律概念，其具体影响的程度，目前尚未能准确评估。上述中美经贸摩擦等相关外部因素，可能导致公司为若干客户提供的晶圆代工及相关配套服务受到一定限制。公司可能面临生产受限、订单减少的局面，进而对公司的业务发展和经营业绩产生不利影响。

（九）原材料和设备供应的风险

集成电路晶圆代工行业对原材料和设备有较高要求，部分重要原材料及核心设备在全球范围内的合格供应商数量较少，大多来自中国境外。

未来，如果公司的重要原材料或者核心设备发生供应短缺、价格大幅上涨，或者供应商所处的国家和地区与中国发生贸易摩擦、外交冲突、战争等进而影响到相应原材料及设备的出口许可，且公司未能及时形成有效的替代方案，将会对公司生产经营及持续发展产生不利影响。

（十）研发风险

公司所处的集成电路晶圆代工行业属于技术密集型行业,集成电路晶圆代工涉及数十种科学技术及工程领域学科知识的综合应用,具有工艺技术迭代快、资金投入大、研发周期长等特点。多年来,公司坚持自主研发的道路,进一步巩固自主化核心知识产权,并致力打造领先于国内乃至国际同类应用的技术平台。

集成电路晶圆代工的技术含量较高,需要经历前期的技术论证及后期的不断研发实践,周期较长。如果公司未来不能紧跟行业前沿需求,正确把握研发方向,可能导致工艺技术定位偏差。同时,新工艺的研发过程较为复杂,耗时较长且成本较高,存在不确定性。如果公司不能及时推出契合市场需求且具备成本效益的技术平台,可能导致公司竞争力和市场份额有所下降,从而影响公司后续发展。

此外,新技术平台的研发需要大量的资金投入。报告期内,公司研发投入分别为 357,607.78 万元、447,090.01 万元及 474,445.66 万元,占营业收入的比例分别为 16.72%、19.42%及 21.55%。如果公司未来技术研发的投入不足,不能支撑技术升级的需要,可能导致公司技术被赶超或替代,进而对公司的持续竞争力产生不利影响。

（十一）知识产权的风险

知识产权是公司在集成电路行业内保持自身竞争力的关键,主要包括专利、集成电路布图设计、商业秘密等。截至 2019 年 12 月 31 日,登记在公司及其控股子公司名下的与生产经营相关的主要专利共 8,122 件,其中境内专利 6,527 件,包括发明专利 5,965 件;境外专利 1,595 件,此外公司还拥有集成电路布图设计 94 件。虽然公司长期以来注重自主知识产权的研发,并建立了科学完善的知识产权保护体系,但不能排除公司的知识产权被盗用或不当使用,或发生知识产权纠纷的风险。

同时,获得第三方公司知识产权许可或引入相关技术授权是集成电路的行业惯例。存在相关知识产权许可或技术授权到期后,因第三方公司原因或因国际贸易摩擦等因素无法继续使用或续期的风险。

未来，如果发生上述风险情形，将对公司的生产经营产生不利影响。同时，公司需采取法律手段维护自身权益，可能耗费一定的人力、物力、财力。

（十二）募集资金投资项目的风险

公司本次公开发行股票的募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金投资额	拟投入资金比例
1	12 英寸芯片 SN1 项目	800,000.00	40.00%
2	先进及成熟工艺研发项目储备资金	400,000.00	20.00%
3	补充流动资金	800,000.00	40.00%
合计		2,000,000.00	100.00%

其中，12 英寸芯片 SN1 项目的募集资金投资额为 800,000.00 万元，用于满足建设 1 条月产能 3.5 万片的 12 英寸生产线项目的部分资金需求，生产技术水平提升至 14 纳米及以下；先进及成熟工艺研发项目储备资金项目的募集资金投资额为 400,000.00 万元，用于工艺研发以提升公司的市场竞争力。未来，如果市场环境、项目实施进度等方面出现重大变化，公司将面临募集资金投资项目无法达到预期收益的风险。

12 英寸芯片 SN1 项目的总投资额为 905,900 万美元，其中生产设备购置及安装费达 733,016 万美元。SN1 项目达产后将会贡献额外的先进制程收入，但同时带来较高的折旧成本压力。随着 14 纳米及下一代制程的产线投产、扩产，公司一定时期内会面临较大的折旧压力，该部分业务毛利率可能会低于公司平均水平，存在经济效益不达预期，甚至产生较大额度亏损的风险。

此外，公司是一家注册在开曼群岛的公司，本次发行募集的资金需要遵守中国境内监管机构对于外商投资和外汇管理的限制，可能对募集资金的使用产生一定影响。

（十三）公司现行的公司治理结构与适用于中国境内法律、法规和规范性文件的上市公司存在差异的风险

公司为一家设立于开曼群岛并在香港联交所上市的红筹企业，现行的公司治理制度主要系基于公司注册地和境外上市地的相关法律法规及规则制定，与目

前适用于注册在中国境内的一般 A 股上市公司的公司治理模式相比，在资产收益、参与重大决策以及剩余财产分配等方面，存在一定差异。

为本次发行上市，公司在适用法律法规允许的范围内，参照境内要求对《公司章程》进行了修订，并对公司治理制度进行了修订和补充。虽然《科创板上市规则》与《香港上市规则》相比，在上市公司重大交易的披露和审批、关联交易的披露和审批、关联方范围界定等方面的规定存在一定差异，但根据本次上市后适用的治理制度，公司在本次发行上市后对于上述差异事项将按照两地上市规则中较为严格者执行，以保证投资者权益保护水平总体上不低于中国法律法规规定的要求。

发行人本次上市后适用的公司治理制度中涉及资产收益、参与重大决策、剩余财产分配等股东核心权益的条款与有关境内要求的对比如下：

1、投资者获取资产收益的权利

《公司章程》和境内要求在资产收益方面没有实质差异。根据《公司章程》，公司可以使用股份溢价进行股息分派，这一点相较于一般境内 A 股上市公司更加灵活。公司股东大会已经批准了《Semiconductor Manufacturing International Corporation（中芯国际集成电路制造有限公司）利润分配政策及首次公开发行人民币普通股（A 股）并在上海证券交易所科创板上市后三年分红回报计划》，对公司利润分配原则、利润分配形式、现金分红条件、现金分红的比例和时间间隔等内容，及本次发行上市后三年分红规划进行了规定，前述计划有利于保障公司全体股东的资产收益权。

2、投资者参与重大决策的权利

根据《公司章程》，公司董事的报酬、公司财务预算方案、公司发行公司债券（不包括发行可转换债券等影响公司股本的证券）、公司向并表企业（构成《香港上市规则》项下“关连人士”的除外）提供担保、变更公司募集资金用途（受限于适用的法律规定）等事项将由董事会决定，而根据境内要求前述事项 A 股上市公司一般需提交股东大会审议。

虽然存在上述差异，但是根据《公司章程》，关于公司业务的根本变化、变更公司授权发行股份总数和已发行在外股份总数、修改公司章程、改选董事、决定分配利润及弥补亏损等公司重大事项的审议权限仍归属于股东大会；此外，公司董事由股东大会任命和罢免（在章程细则中允许董事会任命或罢免的情况除外），其在对公司经营管理事项进行审议时，根据《香港上市规则》和《科创板上市规则》均负有忠实和勤勉义务，并应维护公司和全体股东的利益。因此，《公司章程》中关于股东大会和董事会的职权划分并未损害股东参与公司重大决策的权利。

3、投资者获取剩余财产分配的权利

《公司章程》和境内要求在剩余财产分配方面没有实质差异。

除上述差异以外，作为一家根据《开曼群岛公司法》设立的公司，本公司的一些其他相关安排与一般 A 股上市公司相比还存在差异，主要包括监事会制度（《开曼群岛公司法》没有就监事会的设立作出规定，本公司未设立监事会和监事）、公司合并、分立、收购、公司清算、解散、以资本公积弥补亏损、独立非执行董事机制等，具体参见招股说明书“第七节 公司治理与独立性”之“二、注册地的公司法律制度、《公司章程》与境内《公司法》等法律制度的主要差异”。

（十四）A 股公众股东通过诉讼手段寻求保护自己的权利面临一定不确定性的风险

公司的 A 股公众股东可以依据《证券法》《中华人民共和国民事诉讼法》《中华人民共和国民事诉讼法》《中华人民共和国民事诉讼法》《中华人民共和国民事诉讼法》《中华人民共和国民事诉讼法》《中华人民共和国民事诉讼法》《中华人民共和国民事诉讼法》《中华人民共和国民事诉讼法》《中华人民共和国民事诉讼法》等法律法规及其相关的司法解释，在中国境内有管辖权的人民法院提起民事诉讼，追究公司及其他相关责任人的法律责任，包括在公司的信息披露内容出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并致使 A 股公众股东在证券交易中遭受损失时，A 股公众股东可追索赔偿责任。

虽然 A 股公众股东可以依据中国相关法律法规向有管辖权的人民法院提起诉讼、申请执行公司的境内资产，但是公司注册于开曼群岛，受开曼群岛大法院管辖，如 A 股公众股东向开曼群岛大法院起诉公司寻求保护自己的权利，鉴于

中国目前未与开曼群岛订立双边司法协助的协议或安排，开曼群岛大法院判决能否在中国获得承认与执行，将存在一定的不确定性。

同时，本次发行后，A股公众股东持有的公司股票将统一登记、存管在中国境内的证券登记结算机构。如某一A股公众股东拟依据开曼群岛法律向公司提起证券诉讼或其他民事诉讼，该名A股公众股东须按中国境内相关业务规定取得具有法律效力的证券登记记录，该等程序和限制可能导致境内投资者需承担额外的跨境行使权利或者维护权利的成本和负担。

（十五）公司注册地、上市地和子公司生产经营所涉及的司法辖区相关法律变化的风险

公司是一家设立于开曼群岛的红筹企业，须遵守开曼群岛相关法律的规定。公司通过境内子公司于中国境内开展经营活动，并与设立在其他国家或地区的企业存在采购、销售等往来，因此除了遵守包括但不限于《公司法》《中华人民共和国外商投资法》《中华人民共和国合同法》等相关中国法律、法规和规范性文件的规定外，还须遵守其生产经营活动所涉及的司法辖区相关法律、法规的规定。公司于美国、欧洲、日本、中国香港等国家和地区设立有子公司，该等子公司亦须遵守当地法律、法规的相关规定。

公司及子公司注册地及生产经营活动所涉及的司法辖区的立法机关、政府部门或其他监管机构可能不时发布、更新适用于公司或子公司的法律、法规、规范性文件，该等法律、法规、规范性文件可能对公司或子公司产生实质影响。

2019年1月1日生效的《开曼群岛经济实质法》要求在开曼群岛注册成立的从事“相关活动”的“相关实体”应当满足有关经济实质的要求。公司目前已取得了《存续证明》并在开曼群岛委聘了注册代理，符合《开曼群岛经济实质法》的简化的经济实质测试。但是鉴于《开曼群岛经济实质法》及其指引仍在进一步完善过程中，如果公司从事的业务未来不能归类为“控股业务”，则需要满足更加复杂的经济实质标准。其具体适用条件以及要求尚不明确，如果公司最终无法满足，公司可能受到开曼群岛政府机构的处罚。

此外，本次发行上市后，公司将作为一家在香港联交所和上交所挂牌上市的

公司，需要同时接受两地证券监督管理机构和交易所的监管，并同时遵守包括《科创板上市规则》《香港上市规则》等在内的相关法律、法规、规范性文件的规定。

如果公司或子公司未能完全遵守相关政府机关、监管机构发布、更新的相关规定，则可能面临相应的处罚，并对公司的生产经营、财务状况造成不利影响。

（十六）本次发行股票面值为 0.004 美元，未来触发交易类强制退市情形时股票面值以 1 元人民币为基准

公司为设立在开曼群岛的红筹企业，本次发行股票的面值为 0.004 美元。上交所于 2020 年 6 月 5 日发布了《关于红筹企业申报科创板发行上市有关事项的通知》（上证发〔2020〕44 号），规定红筹企业发行股票的，适用“连续 20 个交易日股票收盘价均低于股票面值”的交易类强制退市情形时，调整为“连续 20 个交易日股票收盘价均低于 1 元人民币”。因此，包括公司在内的红筹企业未来触发交易类强制退市情形时股票面值以 1 元人民币为基准。

（十七）A 股价格波动风险

本次发行上市后，公司将作为一家在香港联交所和上交所挂牌上市的公司。基于两地证券交易规则差异以及港股股票价格波动等因素，A 股股票未来可能面临价格波动的风险。

（十八）在境外增发证券可能导致 A 股投资者权益被摊薄的风险

本次发行上市后，公司将作为一家在香港联交所和上交所挂牌上市的公司。未来公司若在香港联交所增发股票，A 股投资者可能面临权益被摊薄的风险。

（十九）A 股与港股在持续信息披露监管方面存在差异的风险

本次发行上市后，公司将作为一家在香港联交所和上交所挂牌上市的公司，需要同时接受两地证券监督管理机构和交易所的持续信息披露监管，并同时遵守包括《科创板上市规则》《香港上市规则》等在内的相关法律、法规、规范性

文件的规定。A 股与港股在持续信息披露监管方面存在一定差异，可能增加公司未来在信息披露及公司治理等方面的难度及成本。

（二十）发行人股份登记及股东名册管理

本公司本次于上海证券交易所科创板发行的 A 股股票由中登公司上海分公司登记、存管，并按中登公司的登记结算规则以及相关法律、法规、规范性文件的规定办理登记、存管、结算相关业务。

《开曼群岛公司法》第 38 条与第 40 条对公司股东身份的认定以及股东名册需要包含的必要信息进行了相应的规定。此外，根据《开曼群岛公司法》，开曼公司股东名册除应包含前述必要的信息外，开曼公司设置股东名册还应由公司章程作出规定或经公司董事会审议确认。

上海证券交易所为开曼群岛金融管理局批准认可的证券交易所名单中的一员。中芯国际作为一家注册在开曼群岛的公司，可以通过履行内部程序确定由中登公司保管发行人的股东名册。中登公司保管的发行人股东名册中记载的相关法定信息是合法有效的，名称记载于该股东名册中的股东有权行使公司章程赋予发行人股东的全部合法权利。此外，中芯国际在上海证券交易所科创板上市后，股东名册可以按照上海证券交易所等上市地所在国的相关法律、法规、规章、业务规则及其他规范性文件等规定对法定要求的股东信息进行登记。中芯国际 A 股上市后，中登公司保管的 A 股股东名册记载公司本次于上海证券交易所科创板发行的 A 股股票信息。香港中央结算有限公司保管的港股股东名册记载公司本次发行前已在香港联交所发行的股票信息。A 股股东名册与港股股东名册共同构成公司完整的股东名册。

根据本公司的《公司章程》：“本公司依据上海证券交易所提供的凭证建立人民币普通股的股东名册。本公司人民币普通股股东名册的存放地在中国，并委托中国证券登记结算有限责任公司管理。中国证券登记结算有限责任公司出具的股东名册是股东持有本公司股份的合法证明。”根据开曼群岛法律规定，中登公司保管的本公司股东名册中记载的相关法定信息是合法有效的，名称记载于该股东名册中的股东有权行使《公司章程》赋予公司股东的全部合法权利。

中登公司出具的证券登记记录是持有人持有本公司 A 股股票的合法证明。本公司 A 股股东如需取得具有法律效力的证券持有及变动记录证明，应当按中登公司有关业务规定申请办理。

（二十一）发行人股票面值为 0.004 美元并以人民币为股票交易币种在上海证券交易所科创板进行交易

根据《国务院办公厅转发证监会关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见的通知》（国办发〔2018〕21 号）的规定，试点红筹企业的股权结构、公司治理、运行规范等事项可适用境外注册地公司法等法律法规规定。公司作为一家设立于境外开曼群岛的红筹企业，《开曼群岛公司法》允许公司以美元作为面值币种。同时，公司本次发行的股票拟于上交所科创板上市，根据中登公司上海分公司关于科创板股票登记结算的相关规定，科创板股票以人民币结算。公司本次发行的股票以美元为面值币种，并以人民币为股票交易币种在上交所科创板进行交易。公司本次发行股票每股面值与已发行在外的股票每股面值保持一致，为 0.004 美元。

公司本次发行的 A 股股票统一登记、存管于中登公司上海分公司，并按中登公司的登记结算规则以及相关法律、法规、规范性文件的规定办理登记、存管、结算相关业务。鉴于公司本次发行股票的面值为 0.004 美元，登记、存管时，公司按照本次发行招股意向书公告日 2020 年 6 月 30 日中国人民银行公告的人民币汇率中间价（1 美元兑换 7.0795 元人民币）将股票面值折算为相应的人民币金额，该折算面值仅用于中登公司的股份登记。

四、境内投资者权益的保护水平总体上不低于境内法律法规规定的要求

为本次发行上市，发行人在适用法律法规允许的范围内，参照境内要求对《公司章程》进行了修订，并对现有内控制度进行了修订和补充。虽然《科创板上市规则》与《香港上市规则》相比，在上市公司重大交易的披露和审批、关联（连）交易的披露和审批、关联（连）方范围界定等方面的规定存在一定差异，但根据发行人本次发行上市后适用的内控制度，在关于重大交易和关联（连）交易的内

部控制方面，发行人在本次发行上市后将按照两地上市规则中较为严格者执行，以保证投资者权益的保护水平总体上不低于中国法律法规规定的要求。

根据《公司章程》，董事会可全权酌情决定以遥距通讯方式举行股东大会，有权出席股东大会并于会上投票但并非以现场方式出席该大会的股东及受委代表，可透过遥距通讯方式参与股东大会，且视为亲自出席股东大会并于会上投票。此外，根据发行人的确认，在本次发行上市完成后，发行人会根据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》为其人民币普通股股东行使表决权提供网络投票方式。

发行人已经就本次发行上市出具了《关于稳定公司 A 股股价的承诺函》《关于填补本次公开发行人民币普通股（A 股）并在上海证券交易所科创板上市被摊薄即期回报的承诺函》《关于利润分配政策的承诺函》《关于适用法律和管辖法院的承诺函》《关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺函》等承诺。前述承诺已经发行人董事会和股东大会审议通过，且有利于保障投资人的权益。

根据《关于适用法律和管辖法院的承诺函》，发行人承诺“若因公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在上海证券交易所科创板上市以及公司在科创板上市期间所发生的纠纷，将适用中华人民共和国（不包含香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）（简称“中国”）法律，并由中国境内有管辖权的人民法院管辖。公司不会对上述法律适用及法院管辖提出异议。”该等安排有利于保障境内投资者通过诉讼手段维护自身的权益。

经核查，联席保荐机构认为，发行人关于境内投资者权益保护的总体安排不低于境内法律、行政法规及中国证监会的要求。

经核查，发行人律师认为，发行人关于境内投资者权益保护的总体安排不低于境内法律法规及中国证监会的要求。

第二节 股票上市情况

一、股票注册及上市审核情况

(一) 中国证监会同意注册的决定及其主要内容

公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于 2020 年 6 月 29 日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2020]1278 号《关于同意中芯国际集成电路制造有限公司首次公开发行股票注册的批复》）：

“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

(二) 上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

公司首次公开发行股票并在科创板上市已经上海证券交易所批准（上海证券交易所自律监管决定书[2020]197 号文）：

“同意你公司股票在本所科创板上市交易，你公司境内发行股票总数为 168,562 万股，其中 104,023.1223 万股于 2020 年 7 月 16 起上市交易。证券简称为‘中芯国际’，证券代码为‘688981’。”

二、股票上市相关信息

- 1、上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板。
- 2、上市时间：2020 年 7 月 16 日。
- 3、股票简称：中芯国际，扩位简称：中芯国际。
- 4、股票代码：688981。

5、本次公开发行后的股份总数³：7,136,423,226 股（行使超额配售选择权之前）； 7,389,266,226 股（若全额行使超额配售选择权）。

6、本次公开发行的股票数量：1,685,620,000 股（行使超额配售选择权之前）；1,938,463,000 股（若全额行使超额配售选择权）。

7、本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：1,040,231,223 股（行使超额配售选择权之前）。

8、本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：645,388,777 股（行使超额配售选择权之前）。

9、战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：842,810,000 股，其中联席保荐机构跟投的股份数量为 67,424,800 股。

10、发行前股东所持股份的流通限制及期限：发行前股东所持股份在香港联交所流通、交易，未在中登公司进行登记，将不在 A 股市场流通、交易。

11、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：发行前股东所持股份在香港联交所流通、交易，未在中登公司进行登记，将不在 A 股市场流通、交易，因此未出具自愿锁定的相关承诺。

12、本次上市股份的其他限售安排：（1）海通创新证券投资有限公司、中国中金财富证券有限公司分别持有的 33,712,400 股股份限售 24 个月，其他战略投资者所持股份限售 12 个月。（2）网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月；本次发行参与网下配售摇号的共有 2,075 个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 208 个。根据摇号结果，所有摇中的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月。这部分账户对应的股份数量为 55,421,777 股，占网下发行总量的 9.39%，占超额配售启用后扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的 5.06%。

³ 本次发行前后股份总数均以 2020 年 5 月 31 日为基准计算

13、股票登记机构：中国证券登记结算有限公司上海分公司。

14、上市保荐机构：海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司。

三、上市标准

根据《科创板上市规则》《国务院办公厅转发证监会关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见的通知》（国办发〔2018〕21号）及《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》（中国证券监督管理委员会公告〔2020〕26号），发行人作为已在境外上市的红筹企业选择的具体上市标准为：“市值200亿元人民币以上，且拥有自主研发、国际领先技术，科技创新能力较强，同行业竞争中处于相对优势地位。”

本次发行价格确定后发行人上市时市值（本次发行价格乘以本次发行后总股数）约为1,959.66亿元（超额配售选择权行使前），2,029.09亿元（超额配售选择权全额行使后），满足招股说明书中明确选择的具体上市标准。

第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况

一、发行人基本情况

英文名称	Semiconductor Manufacturing International Corporation
中文名称	中芯国际集成电路制造有限公司
法定股本总额	42,000,000.00 美元
法定股份总数	10,500,000,000 股（包括：10,000,000,000 股普通股、500,000,000 股优先股）
已发行股份总数 ⁴	5,450,803,226 股（普通股）
公司董事	周子学、ZHAO HAIJUN（赵海军）、梁孟松、高永岗、童国华、陈山枝、路军、任凯、周杰、刘遵义、WILLIAM TUDOR BROWN、JINGSHENG JASON CONG（丛京生）、范仁达、KWANG-LEEI YOUNG（杨光磊）
成立日期	2000 年 4 月 3 日
注册地址	Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111 Cayman Islands
主要生产经营地址	中国上海市浦东新区张江路 18 号
经营范围	不适用
主营业务	公司是全球领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国大陆技术最先进、规模最大、配套服务最完善、跨国经营的专业晶圆代工企业，主要为客户提供 0.35 微米至 14 纳米多种技术节点、不同工艺平台的集成电路晶圆代工及配套服务
所属行业	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业（《上市公司行业分类指引》）
邮政编码	201203
联系电话	86-21-38610000
传真号码	86-21-50802868
互联网网址	www.smics.com
公司邮箱	ir@smics.com
信息披露负责部门	董事会办公室
信息披露境内代表	郭光莉
联系电话	86-21-20812800
投资者关系负责部门	投资者关系部
负责人	郭廷谦
联系电话	86-21-20812804

二、控股股东、实际控制人基本情况

⁴ 本次发行前后股份总数均以 2020 年 5 月 31 日为基准计算

报告期内，公司股权较为分散，任何单一股东持股比例均低于 30.00%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司第一大股东大唐香港持股比例为 17.00%，第二大股东鑫芯香港持股比例为 15.76%，董事会现有 14 位董事，各股东提名的董事人数均低于董事总人数的二分之一，不存在单一股东通过实际支配公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任或足以对股东大会的决议产生重大影响的情形，且公司主要股东之间无关联关系、一致行动关系，因此，公司无控股股东和实际控制人。

三、董事、高级管理人员基本情况

（一）董事基本情况

截至本上市公告书签署日，公司董事任职情况及其截至 2019 年 12 月 31 日持有公司权益的情况如下：

姓名	职务	董事类别及任期	普通股 (股)	限售 期限	尚未行权的 股权激励对 应普通股股 数(股)	债券 (元)
周子学	董事长、执行董事	第一类董事，任期为 2020.06.23 至 (a) 2023.06.22；或 (b) 2023 年股东周年大会之日期（以较早者为准）	-	-	3,601,661	-
ZHAO HAIJUN (赵海军)	联合首席执行官、执行董事	第二类董事，任期为 2018.06.22 至 (a) 2021.06.21；或 (b) 2021 年股东周年大会之日期（以较早者为准）	163	-	1,875,733	-
梁孟松	联合首席执行官、执行董事	第三类董事，任期为 2019.06.21 至 (a) 2022.06.20；或 (b) 2022 年股东周年大会之日期（以较早者为准）	-	-	-	-
高永岗	首席财务官、执行副总裁、联席公司秘书兼执行董事	第一类董事，任期为 2020.06.23 至 (a) 2023.06.22；或 (b) 2023 年股东周年大会之日期（以较早者为准）	-	-	1,734,977	-
童国华	非执行董事	第一类董事，任期为 2020.06.23 至 (a) 2023.06.22；或 (b) 2023 年股东周年大会之日期（以较早者为准）	-	-	375,000	-
陈山枝	非执行董事	第二类董事，任期为 2018.06.22 至 (a) 2021.06.21；或 (b) 2021 年股东周年大会之日期（以较早者为准）	-	-	1,014,843	-

姓名	职务	董事类别及任期	普通股 (股)	限售 期限	尚未行权的 股权激励对 应普通股股 数(股)	债券 (元)
		者为准)				
路军	非执行董事	第二类董事, 任期为 2018.06.22 至 (a) 2021.06.21; 或 (b) 2021 年股东周年大会之日期 (以较早者为准)	-	-	-	-
任凯	非执行董事	第三类董事, 任期为 2019.06.21 至 (a) 2022.06.20; 或 (b) 2022 年股东周年大会之日期 (以较早者为准)	-	-	-	-
周杰	非执行董事	第三类董事, 任期为 2019.06.21 至 (a) 2022.06.20; 或 (b) 2022 年股东周年大会之日期 (以较早者为准)	-	-	-	-
刘遵义	独立非执行董事	第二类董事, 任期为 2019.06.21 至 (a) 2022.06.20; 或 (b) 2021 年股东周年大会之日期 (以较早者为准)	-	-	375,000	-
WILLIAM TUDOR BROWN	独立非执行董事	第一类董事, 任期为 2020.06.23 至 (a) 2023.06.22; 或 (b) 2023 年股东周年大会之日期 (以较早者为准)	-	-	300,000	-
JINGSHEN G JASON CONG (丛京生)	独立非执行董事	第三类董事, 任期为 2019.06.21 至 (a) 2022.06.20; 或 (b) 2022 年股东周年大会之日期 (以较早者为准)	123,750	-	251,250	-
范仁达	独立非执行董事	第二类董事, 任期为 2019.06.21 至 (a) 2022.06.20; 或 (b) 2021 年股东周年大会之日期 (以较早者为准)	-	-	375,000	-
KWANG-LEEI YOUNG (杨光磊)	独立非执行董事	第三类董事, 任期为 2020.06.23 至 (a) 2023.06.22; 或 (b) 2022 年股东周年大会之日期 (以较早者为准)	-	-	375,000	-

(二) 高级管理人员基本情况

截至本上市公告书签署日, 公司高级管理人员任职情况及其截至 2019 年 12 月 31 日持有公司权益的情况如下:

姓名	职务	任职起始期 ⁵	普通股 (股)	限售 期限	尚未行权的股权 激励对应普通股 股数(股)	债券 (元)
----	----	--------------------	------------	----------	-----------------------------	-----------

⁵ 公司未与高级管理人员约定任期结束时间

ZHAO HAIJUN (赵海军)	联合首席执行官	2017年5月	163	-	1,875,733	-
梁孟松	联合首席执行官	2017年10月	-	-	-	-
高永岗	执行副总裁	2013年6月	-	-	1,734,977	-
	首席财务官	2014年2月				
ZHOU MEISHENG (周 梅生)	技术研发执行副 总裁	2017年10月	-	-	-	-

四、核心技术人员基本情况

截至本上市公告书签署日，公司核心技术人员任职情况及其截至2019年12月31日持有公司权益的情况如下：

姓名	职务	普通股 (股)	限售 期限	尚未行权的 股权激励对 应普通股股 数(股)
ZHAO HAIJUN (赵海军)	执行董事、联合首席执行官	163	-	1,875,733
梁孟松	执行董事、联合首席执行官	-	-	-
ZHOU MEISHENG (周梅生)	技术研发执行副总裁	-	-	-
ZHANG XIN (张昕)	运营与工程资深副总裁	-	-	342,358
吴金刚	技术研发副总裁	-	-	171,050

五、股权激励情况

截至2019年12月31日，公司存续的以港股股票为激励方式的股权激励包括：《2004年购股权计划》《2014年购股权计划》《2014年以股支薪奖励计划》，其中《2004年购股权计划》已过授予期，不可再授予购股权。

截至2019年12月31日，公司根据上述股权激励计划尚可授予的购股权/受限制股份单位对应的普通股为318,161,349股，占2019年12月31日已发行普通股的6.29%；已授予尚未行权的购股权/受限制股份单位对应普通股为49,162,543股，占2019年12月31日已发行普通股的0.97%，具体情况如下：

序号	股权激励计划	已授予未行使购股权/受限制股份单位对应普通股		尚可授予购股权/受限制股份单位对应普通股		合计
		股份数(股)	占比	股份数(股)	占比	
1	2004年购股权计划	14,553,897	0.29%	-	-	0.29%
2	2014年购股权计划	24,801,327	0.49%	285,875,152	5.65%	6.14%
3	2014年以股支薪奖励计划	9,807,319	0.19%	32,286,197	0.64%	0.83%

合计	49,162,543	0.97%	318,161,349	6.29%	7.26%
----	------------	-------	-------------	-------	-------

上述股权激励计划行权后对应的港股股票在香港联交所流通、交易，目前无法在中登公司进行登记，将不在 A 股市场流通、交易。

六、本次发行前后的股本结构变动情况

本次发行前后⁶公司股本结构如下：

股东名称	本次发行前		本次发行后 (行使超额配售选择权之前)		本次发行后 (若全额行使超额配售选择权)		限售期限
	股份数量 (股)	占比 (%)	股份数量 (股)	占比 (%)	股份数量 (股)	占比 (%)	
一、A 股限售流通股							
中国信息通信科技集团有限公司	-	-	0	0	72,470,855	0.98%	12 个月
国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	-	-	0	0	127,458,120	1.72%	12 个月
上海集成电路产业投资基金股份有限公司	-	-	0	0	18,208,302	0.25%	12 个月
中国国有资本风险投资基金股份有限公司	-	-	6,190,824	0.09%	6,190,824	0.08%	12 个月
北京通服科创服务贸易投资管理合伙企业（有限合伙）	-	-	18,208,302	0.26%	18,208,302	0.25%	12 个月
中国保险投资基金（有限合伙）	-	-	54,624,908	0.77%	54,624,908	0.74%	12 个月
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	-	-	36,416,605	0.51%	36,416,605	0.49%	12 个月
国新投资有限公司	-	-	36,416,605	0.51%	36,416,605	0.49%	12 个月
国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）	-	-	9,832,484	0.14%	9,832,484	0.13%	12 个月
国开科技创业投资有限责任公司	-	-	1,820,830	0.03%	1,820,830	0.02%	12 个月
光大兴陇信托有限责任公司	-	-	14,493,809	0.20%	14,493,809	0.20%	12 个月
上海科技创业投资（集团）有限公司	-	-	18,208,302	0.26%	18,208,302	0.25%	12 个月
上海国际集团资产管理有限公司	-	-	3,623,452	0.05%	3,623,452	0.05%	12 个月
上海浦东科创集团有限公司	-	-	18,208,302	0.26%	18,208,302	0.25%	12 个月

⁶ 本次发行前后股份总数均以 2020 年 5 月 31 日为基准计算。本次发行前，发行人已发行港股普通股 5,450,803,226 股，无 A 股普通股。上述港股股票目前在香港联交所流通、交易，未在中登公司进行登记，将不在 A 股市场流通、交易

深圳市创新投资集团有限公司	-	-	18,208,303	0.26%	18,208,303	0.25%	12个月
北京屹唐同舟股权投资中心(有限合伙)	-	-	18,208,302	0.26%	18,208,302	0.25%	12个月
北京金融街资本运营中心	-	-	3,641,660	0.05%	3,641,660	0.05%	12个月
合肥市创新科技风险投资有限公司	-	-	3,641,660	0.05%	3,641,660	0.05%	12个月
金控天勤(杭州)创业投资合伙企业(有限合伙)	-	-	10,924,981	0.15%	10,924,981	0.15%	12个月
人民日报媒体技术股份有限公司	-	-	10,924,981	0.15%	10,924,981	0.15%	12个月
新华人寿保险股份有限公司	-	-	18,208,302	0.26%	18,208,302	0.25%	12个月
大家人寿保险股份有限公司	-	-	14,622,295	0.20%	14,622,295	0.20%	12个月
上海复星高科技(集团)有限公司	-	-	18,208,303	0.26%	18,208,303	0.25%	12个月
马鞍山联力昭离少商集成电路投资合伙企业(有限合伙)	-	-	18,208,302	0.26%	18,208,302	0.25%	12个月
GICPrivateLimited	-	-	109,249,819	1.53%	109,249,819	1.48%	12个月
AbuDhabiInvestmentAuthority	-	-	14,566,643	0.20%	14,566,643	0.20%	12个月
青岛聚源芯星股权投资合伙企业(有限合伙)	-	-	45,884,226	0.64%	80,589,949	1.09%	12个月
海通创新证券投资有限公司	-	-	33,712,400	0.47%	33,712,400	0.46%	24个月
中国中金财富证券有限公司	-	-	33,712,400	0.47%	33,712,400	0.46%	24个月
其他限售流通股	-	-	55,421,777	0.78%	55,421,777	0.75%	6个月
小计	-	-	645,388,777	9.04%	898,231,777	12.16%	-
二、A股无限售流通股							
无限售流通股	-	-	1,040,231,223	14.58%	1,040,231,223	14.08%	-
小计	-	-	1,040,231,223	14.58%	1,040,231,223	14.08%	-
三、境外上市股份⁷							
港股	5,450,803,226	100%	5,450,803,226	76.38%	5,450,803,226	73.77%	-
小计	5,450,803,226	100%	5,450,803,226	76.38%	5,450,803,226	73.77%	-
合计	5,450,803,226	100%	7,136,423,226	100.00%	7,389,266,226	100.00%	-

注 1：中国信息通信科技集团有限公司通过本次发行战略配售实际获配 72,470,855 股，因实施超额配售选择权递延交付 72,470,855 股（计入无限售流通股）。因此，在本次上市当日持股数量为 0 股。在后市稳定期结束后，中国信息通信科技集团有限公司最终持有股份数量为 72,470,855 股。

⁷ 本次发行前，发行人已发行港股普通股 5,450,803,226 股，无 A 股普通股。上述港股股票目前在香港联交所流通、交易，未在中登公司进行登记，将不在 A 股市场流通、交易

注 2：国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司通过本次发行战略配售实际获配 127,458,120 股，因实施超额配售选择权递延交付 127,458,120 股（计入无限售流通股）。因此，在本次上市当日持股数量为 0 股。在后市稳定期结束后，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司最终持有股份数量为 127,458,120 股。

注 3：上海集成电路产业投资基金股份有限公司通过本次发行战略配售实际获配 18,208,302 股，因实施超额配售选择权递延交付 18,208,302 股（计入无限售流通股）。因此，在本次上市当日持股数量为 0 股。在后市稳定期结束后，上海集成电路产业投资基金股份有限公司最终持有股份数量为 18,208,302 股。

注 4：青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）通过本次发行战略配售实际获配 80,589,949 股，因实施超额配售选择权递延交付 34,705,723 股（计入无限售流通股）。因此，在本次上市当日持股数量为 45,884,226 股。在后市稳定期结束后，上海集成电路产业投资基金股份有限公司最终持有股份数量为 80,589,949 股。

发行人本次公开发行前的股东在首次公开发行股票时不存在向投资者公开发售股份的情况。

七、本次发行后持 A 股数量前十名股东

本次发行后持公司 A 股数量前十名股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (超额配售选择 权实施前)	持股比例 (超额配售选择 权全额实施后)	限售期限
1	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	127,458,120	1.79%	1.72%	12 个月
2	GICPrivateLimited	109,249,819	1.53%	1.48%	12 个月
3	青岛聚源芯星股权投资合伙企业 (有限合伙)	80,589,949	1.13%	1.09%	12 个月
4	中国信息通信科技集团有限公司	72,470,855	1.02%	0.98%	12 个月
5	中国保险投资基金(有限合伙)	54,624,908	0.77%	0.74%	12 个月
6	中国国有企业结构调整基金股份 有限公司	36,416,605	0.51%	0.49%	12 个月
7	国新投资有限公司	36,416,605	0.51%	0.49%	12 个月
8	海通创新证券投资有限公司	33,712,400	0.47%	0.46%	24 个月
9	中国中金财富证券有限公司	33,712,400	0.47%	0.46%	24 个月
10	深圳市创新投资集团有限公司	18,208,303	0.26%	0.25%	12 个月
	合计	602,859,964	8.46%	8.16%	

注 1：本次发行后持 A 股数量前十名股东中，战略投资者中国信息通信科技集团有限

公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司、青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）共获配 298,727,226 股，因上述战略投资者同意联席主承销商延期交付其获配股票，因此在本次上市当日，上述战略投资者实际持股数量之和为 45,884,226 股，在后市稳定期结束后，联席主承销商将交付其剩余获配股份。

注 2：持股比例=持股数量÷本次发行后的总股数（即 A 股股数与港股股数之和）。

八、发行人、主承销商向其他战略投资者配售股票情况

发行人、联席主承销商向其他战略投资者配售股票的情况如下：

序号	战略投资者名称	获配股数（股）	限售期限
1	中国信息通信科技集团有限公司	72,470,855.00	12 个月
2	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	127,458,120.00	12 个月
3	上海集成电路产业投资基金股份有限公司	18,208,302.00	12 个月
4	中国国有资本风险投资基金股份有限公司	6,190,824.00	12 个月
5	北京通服科创服务贸易投资管理合伙企业（有限合伙）	18,208,302.00	12 个月
6	中国保险投资基金（有限合伙）	54,624,908.00	12 个月
7	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	36,416,605.00	12 个月
8	国新投资有限公司	36,416,605.00	12 个月
9	国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）	9,832,484.00	12 个月
10	国开科技创业投资有限责任公司	1,820,830.00	12 个月
11	光大兴陇信托有限责任公司	14,493,809.00	12 个月
12	上海科技创业投资（集团）有限公司	18,208,302.00	12 个月
13	上海国际集团资产管理有限公司	3,623,452.00	12 个月
14	上海浦东科创集团有限公司	18,208,302.00	12 个月
15	深圳市创新投资集团有限公司	18,208,303.00	12 个月
16	北京屹唐同舟股权投资中心（有限合伙）	18,208,302.00	12 个月
17	北京金融街资本运营中心	3,641,660.00	12 个月
18	合肥市创新科技风险投资有限公司	3,641,660.00	12 个月
19	金控天勤（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）	10,924,981.00	12 个月
20	人民日报媒体技术股份有限公司	10,924,981.00	12 个月
21	新华人寿保险股份有限公司	18,208,302.00	12 个月
22	大家人寿保险股份有限公司	14,622,295.00	12 个月
23	上海复星高科技（集团）有限公司	18,208,303.00	12 个月
24	马鞍山联力昭离少商集成电路投资合伙企业（有限合伙）	18,208,302.00	12 个月
25	GIC Private Limited	109,249,819.00	12 个月
26	Abu Dhabi Investment Authority	14,566,643.00	12 个月

27	青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）	80,589,949.00	12 个月
合计		775,385,200.00	

九、保荐机构相关子公司参与本次发行战略配售情况

（一）海通证券相关子公司参与本次发行战略配售情况

- 1、保荐机构相关子公司名称：海通创新证券投资有限公司。
- 2、保荐机构相关子公司与保荐机构的关系：海通创新证券投资有限公司为海通证券股份有限公司的另类投资子公司。
- 3、获配股数：33,712,400 股。
- 4、占首次公开发行股票数量的比例：2.00%（行使超额配售选择权之前）、1.74%（若全额行使超额配售选择权）。
- 5、限售安排：限售期 24 个月。

（二）中金公司相关子公司参与本次发行战略配售情况

- 1、保荐机构相关子公司名称：中国中金财富证券有限公司。
- 2、保荐机构相关子公司与保荐机构的关系：中国中金财富证券有限公司为中国国际金融股份有限公司的全资子公司。
- 3、获配股数：33,712,400 股。
- 4、占首次公开发行股票数量的比例：2.00%（行使超额配售选择权之前）、1.74%（若全额行使超额配售选择权）。
- 5、限售安排：限售期 24 个月。

第四节 股票发行情况

一、首次公开发行股票的情况

（一）发行数量

本次发行的初始发行股票数量为 1,685,620,000 股，占发行后股份总数的 23.62%（超额配售选择权行使前）。发行人授予海通证券不超过初始发行规模 15% 的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行股份总数将扩大至 1,938,463,000 股，占发行后股份总数的 26.23%（若全额行使超额配售选择权）。

本次发行不涉及股东公开发售股份。

（二）发行价格

本次发行价格为 27.46 元/股。

（三）每股面值

每股面值为 0.004 美元。

（四）市盈率⁸

1、109.25 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前的归属于母公司股东净利润除以未考虑超额配售选择权时本次发行后总股数计算）；

2、113.12 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前的归属于母公司股东净利润除以假设全额行使超额配售选择权时本次发行后总股数计算）。

（五）市净率

1、2.20 倍（每股净资产按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则

⁸ 发行人 2019 年度扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润为-52,209.54 万元，故不适用扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润对应的市盈率指标

审计归属于母公司股东的净资产与本次募集资金净额之和除以未考虑超额配售选择权时本次发行后总股数计算)；

2、2.11 倍（每股净资产按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计归属于母公司股东的净资产与本次募集资金净额之和除以假设全额行使超额配售选择权时本次发行后总股数计算）。

（六）发行后每股收益

不适用。

（七）发行后每股净资产

行使超额配售选择权之前：12.50 元，若全额行使超额配售选择权：13.00 元（按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计归属于母公司股东的净资产除以本次发行后已发行股份总数计算）。

（八）募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

在行使超额配售选择权之前，本次发行的募集资金总额为 4,628,712.52 万元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 14 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了普华永道中天验字[2020]第 0590 号《验资报告》。

（九）发行费用总额及明细构成⁹

项目	金额（万元）
保荐及承销费用	60,173.26（行使超额配售选择权之前） 69,199.25（若全额行使超额配售选择权）
审计费用	368.38
律师费用	1,294.98
用于本次发行的信息披露费用	490.00
发行手续费用及其他	106.06
合计	62,432.69（行使超额配售选择权之前） 71,458.68（若全额行使超额配售选择权）

⁹ 以上各项发行费用均含增值税，本次发行时实际发生的费用较招股意向书的披露金额有所调整

（十）募集资金净额

本次发行募集资金净额为 4,566,279.83 万元（行使超额配售选择权之前）；5,251,560.72 万元（若全额行使超额配售选择权）。

（十一）发行后股东户数

本次发行后，A 股股东户数为 892,309 户。

二、超额配售选择权的情况

- 1、全额行使超额配售选择权发行股票的具体数量：252,843,000 股
- 2、全额行使超额配售选择权发行股票占首次公开发行股票数量的比例：15%
- 3、超额配售选择权的实施期限：股票上市之日起 30 个自然日内
- 4、与参与本次配售的投资者达成的延期交付股份安排：

除新加坡政府投资有限公司（GIC Private Limited）、阿布达比投资局（Abu Dhabi Investment Authority）之外，本次发行的战略投资者与发行人及联席保荐机构签署的《附有生效条件的战略投资者股份认购协议》以及《递延交付战略投资者认购股份的协议》中明确递延交付条款，战略投资者同意若本次发行采用超额配售选择权，海通证券可以晚于发行人上市日期之日向战略投资者交付其全部或部分获配股票。

目前，除新加坡政府投资有限公司（GIC Private Limited）、阿布达比投资局（Abu Dhabi Investment Authority）之外的其他战略投资者均接受协议约定的延期交付安排，可以覆盖延期交付部分股票的规模。

- 5、具体实施方案：

（1）预期目标

本次发行的初始发行股票数量为 168,562.00 万股，占发行后股份总数的 23.62%（超额配售选择权行使前）。发行人授予海通证券不超过初始发行规模 15% 的超额配售选择权（或称“绿鞋”），若超额配售选择权全额行使，则发行股份总

数将扩大至 193,846.30 万股，占发行后股份总数的 26.23%（超额配售选择权全额行使后）。本次超额配售选择权的安排有利于促进发行人上市后的股价稳定。

（2）实施方案

根据发行人授权，海通证券担任本次发行具体实施超额配售选择权操作的联席主承销商（以下简称“获授权联席主承销商”）。

自公司股票在上海证券交易所上市之日起 30 个自然日内，公司股票的市场交易价格低于发行价格的，海通证券有权使用超额配售股票募集资金在连续竞价时间以《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》规定的本方最优价格申报方式购买公司股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价。另外，海通证券以竞价交易方式买入的股票不得卖出。

海通证券未购买公司股票或者购买公司股票数量未达到全额行使超额配售选择权发行股票数量的，可以要求公司按照发行价格增发股票。海通证券以竞价交易方式购买的发行人股票与要求发行人增发的股票之和，不得超过《中芯国际集成电路制造有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》中披露的全额行使超额配售选择权拟发行股票数量。

超额配售选择权行使期届满或者累计购回股票数量达到采用超额配售选择权发行股票数量限额的日期、因行使超额配售选择权而发行的新股数量、发行人本次筹资总金额等情况将在超额配售选择权行使期届满或者累计购回股票数量达到采用超额配售选择权发行股票数量限额的 2 个工作日内进行公告披露。

海通证券在符合相关法律法规规定的条件下，可以在发行人股票上市后 30 个自然日内以超额配售股票所得的资金从二级市场买入本次发行的股票以支持股价，但该措施并不能保证股价不下跌。海通证券在超额配售选择权行使期届满或者累计购回股票数量达到采用超额配售选择权发行股票数量限额的 5 个工作日内，将超额配售选择权专用账户上所有股份向同意递延交付股票的战略投资者交付。海通证券在发行人股票上市后 30 个自然日之后或行使超额配售选择权后，将不再采取上述措施支持股价。

（3）配售安排

本次超额配售股票通过向本次发行的部分战略投资者递延交付的方式获得，并全部向网上投资者配售。最终超额配售情况已在《中芯国际集成电路制造有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》中公布。

（4）操作策略

获授权联席主承销商海通证券已根据《证券发行与承销管理办法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》《科创板首次公开发行股票承销业务规范》等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件制定了《海通证券股份有限公司科创板首次公开发行股票超额配售选择权业务实施细则》。海通证券已根据该实施细则制定具体操作策行使超额配售选择权。

（5）预期效果

因行使超额配售选择权超额发行的股数=发行时超额配售股数-使用超额配售股票所获得的资金从二级市场净买入的股数。具体行使超额配售选择权包括以下三种情况：

①绿鞋不行使。超额配售股数为 25,284.30 万股，占本次初始发行规模的 15%，且海通证券从二级市场买入的股票数量与超额配售股数相同；

②绿鞋全额行使。超额配售股数为 25,284.30 万股，占本次初始发行规模的 15%，且海通证券从二级市场买入本次发行的股票数量为零，并要求发行人超额发行本次发行初始发行规模 15%的股票；

③绿鞋部分行使。超额配售股数为 25,284.30 万股，占本次初始发行规模的 15%，且海通证券从二级市场买入的股票数量小于超额配售股数，因此要求发行人超额发行的股票数量小于本次发行初始发行规模的 15%。

海通证券在符合相关法律法规规定的条件下，可在发行人股票上市后 30 个自然日内以超额配售股票所得的资金从二级市场买入本次发行的股票以支持股价，但该措施并不能保证股价不下跌。海通证券在发行人股票上市后 30 个自然日之后或行使超额配售选择权后，将不再采取上述措施支持股价。

第五节 财务会计情况

本公司 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日的合并资产负债表，2017 年度、2018 年度及 2019 年度的合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表以及相关财务报表附注已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了普华永道中天审字（2020）第 11026 号无保留意见的审计报告。相关数据已在招股说明书中进行了详细披露，投资者欲了解相关情况请仔细阅读招股说明书，本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。

本公司 2020 年 3 月 31 日的合并资产负债表、截至 2020 年 3 月 31 日止 3 个月期间的合并利润表、合并现金流量表和合并股东权益变动表以及相关财务报表附注已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，并出具了普华永道中天阅字（2020）第 0060 号审阅报告。相关数据已在招股说明书中进行了详细披露，投资者欲了解相关情况请仔细阅读招股说明书，本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。

一、下一报告期业绩预计信息

本公司于 2020 年 5 月 13 日在香港联交所公告了依据国际财务报告准则编制的《中芯国际截至 2020 年 3 月 31 日止三个月未经审核业绩公布》，预测 2020 年第二季度收入环比增加 3%至 5%，毛利率介于 26%至 28%的范围内，主要系公司产能、产量增加带来的规模效应及产品组合的优化。

二、财务报告审计截止日后主要经营情况

财务报告审计截止日后至本上市公告书签署日，公司的整体经营环境未发生较大变化，经营状况良好，经营模式未发生重大变化，公司的主要原材料采购、技术研发、生产及销售等业务运转正常，不存在将导致公司业绩异常波动的重大不利因素。

第六节 其他重要事项

一、募集资金专户存储四方监管协议的安排

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，本公司已与联席保荐机构海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司及存放募集资金的商业银行招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，《募集资金专户存储四方监管协议》对发行人、联席保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。具体情况如下：

序号	监管银行	开户人	募集资金专户账号	币种
1	招商银行股份有限公司上海分行	中芯国际	NRA110925662010101	人民币
2	招商银行股份有限公司上海分行	中芯国际	NRA110925662032501	美元

二、其他事项

除此之外，本公司在招股意向书披露日至上市公告书刊登前，未发生《证券法》《上市公司信息披露管理办法》规定的重大事件，具体如下：

- 1、本公司主营业务发展目标进展情况正常，经营状况正常。
- 2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。
- 3、除正常经营活动所签订的商务合同外，本公司未订立其他对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。
- 4、本公司没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在招股说明书中披露的重大关联交易。
- 5、本公司未进行重大投资。
- 6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。
- 7、本公司住所未发生变更。
- 8、本公司董事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化。
- 9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

- 10、本公司未发生对外担保等或有事项。
- 11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
- 12、本公司股东大会、董事会运行正常，决议及其内容无异常。
- 13、本公司未发生其他应披露的重大事项，招股意向书中披露的事项，未发生重大变化。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构的推荐意见

上市联席保荐机构认为：发行人申请其股票上市符合《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的规定，发行人股票具备在上海证券交易所科创板上市的条件。海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司同意推荐中芯国际集成电路制造有限公司在上海证券交易所科创板上市。

二、上市保荐机构情况

1、联席保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

法定代表人：周杰

住所：上海市黄浦区广东路 689 号

保荐代表人：郑瑜、陈城

项目协办人：徐亦潇

其他项目人员：孙炜、丁昊、宋轩宇、马意华、韩锦玮、景炆、陈佳一、邬凯丞、宋一波、陈颖涛、沈玉峰、张坤、程万里、吴志君、孙剑峰

联系人：郑瑜、陈城

电话：021-23219000

传真：021-63411627

2、联席保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

法定代表人：沈如军

住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

保荐代表人：魏先勇、李扬

项目协办人：孔德明

其他项目人员：孙雷、吴迪、陈恪舟、曹毅程、王若钰、张焱远、刘冰冰、徐放、戴志远、何柳

联系人：魏先勇、李扬

电话：010-65051166

传真：010-65051156

三、提供持续督导的保荐代表人情况

郑瑜先生，海通证券股份有限公司投资银行部执行董事，2010年加入海通证券投资银行部。主要参与了苏州天准科技股份有限公司 IPO 项目、上海泛微网络科技股份有限公司 IPO 项目、南京佳力图机房环境技术股份有限公司 IPO 项目、湖北回天新材料股份有限公司非公开增发项目、上海北特科技股份有限公司 IPO 项目及非公开增发项目、四川大通燃气开发股份有限公司非公开增发项目、国美通讯设备股份有限公司重大资产重组项目、福建省闽发铝业股份有限公司 IPO 项目、嘉友国际物流股份有限公司 IPO 项目等。郑瑜先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。

陈城先生，海通证券股份有限公司投资银行部高级副总裁，2013年加入海通证券投资银行部。主要参与了常熟瑞特电气股份有限公司 IPO 项目、上海泛微网络科技股份有限公司 IPO 项目、江苏力星通用钢球股份有限公司 IPO 及非公开增发项目、上海徕木电子股份有限公司 IPO 项目等。陈城先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。

魏先勇先生，中国国际金融股份有限公司投资银行部执行总经理，于 2014 年取得保荐代表人资格，曾经担任华润微电子有限公司科创板首次公开发行项目、中远海运控股股份有限公司非公开发行项目的保荐代表人，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

李扬先生，中国国际金融股份有限公司投资银行部执行总经理，于 2015 年取得保荐代表人资格，曾经担任上海畅联国际物流股份有限公司首次公开发行

项目、青岛海尔股份有限公司公开发行可转换公司债券项目、南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券项目的保荐代表人，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

第八节 重要承诺事项

一、稳定股价的措施和承诺

为保持上市后股价稳定，发行人制定了《关于首次公开发行人民币普通股（A股）并在上海证券交易所科创板上市后三年稳定公司A股股价的预案》如下：

“1、启动稳定股价的触发条件

自股票在上海证券交易所科创板挂牌上市之日起三年内，若非因不可抗力因素所致，出现连续20个交易日公司股票收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）情形时，公司将自行或促使本预案中涉及的其他主体依照本预案的规定启动股价稳定措施。

2、公司稳定股价的主要措施与程序

当预案的触发条件成就后，公司应依照法律、法规、规范性文件、《Semiconductor Manufacturing International Corporation（中芯国际集成电路制造有限公司）组织章程大纲及章程细则》及公司相关制度的规定，采取以下全部或部分措施稳定公司股价：

（1）在不影响公司正常生产经营的情况下，经公司根据适用法律、法规及规范性文件有权批准的内部机构审议同意，公司向社会公众股东回购股票；

（2）在上述（1）项措施实施完毕后公司股票收盘价格仍低于最近一期经审计的每股净资产的，公司应要求领薪董事（独立非执行董事除外）、高级管理人员增持公司股票（前提是该等人员有资格购买股票）；

（3）其他法律、法规、规范性文件规定以及中国证券监督管理委员会或上海证券交易所认可的其他稳定股价的方式。

公司应保证上述股价稳定措施实施过程中及实施后，公司的股权分布始终符合香港联合交易所有限公司主板和上海证券交易所科创板上市条件。

3、公司回购股票

公司回购股票应当符合开曼群岛法律法规、上市所在地证券监管机构、证券交易所监管规则及《公司章程》等规定。公司董事会将在本公司股票价格触发本预案启动股价稳定措施条件之日起的合理时间内制订稳定本公司股价具体方案，并提交董事会和/或股东大会批准。具体回购方案应在董事会和/或股东大会作出股份回购决议后公告。

在股东大会和/或董事会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债权人（如需），并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续（如需）。

公司回购股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），回购股份的方式为集中竞价、要约或证券监督管理部门认可的其他方式。如果股份回购方案实施前公司股票价格已经不满足预案触发条件的，则公司无须继续实施该方案。

若某一会计年度内公司股价多次出现触发本预案规定的股价稳定措施的情形（不包括公司实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于最近一期经审计的每股净资产的情形），公司将分别按照本预案执行股价稳定措施，除非公司出现股份回购方案约定的当年度可中止实施稳定股价措施的情形。在某一会计年度公司中止执行股价稳定措施的情况下，若下一年度继续出现触发本预案规定的稳定股价措施的情形时，公司将继续按照本预案执行。

4、公司领薪董事（不包括独立非执行董事）和高级管理人员增持股票

若公司根据本预案实施完毕稳定股价措施后公司股票收盘价格仍低于最近一期经审计的每股净资产的，在不影响公司股权分布始终符合上市条件，且符合上市地适用法律法规的前提下，公司领薪董事（不包括独立非执行董事）和高级管理人员应根据公司的要求在合理期间内增持公司股票。

公司领薪董事（不包括独立非执行董事）和高级管理人员通过二级市场以竞价方式买入公司股份的，买入价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产（因

利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）。但如果在增持股票前公司股票价格已经不能满足预案触发条件的，公司领薪董事（不包括独立非执行董事）和高级管理人员可不再继续实施稳定股价的措施。

若某一会计年度内公司股价多次出现触发本预案规定的股价稳定措施的情形（不包括公司领薪董事（不包括独立非执行董事）和高级管理人员实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于最近一期经审计的每股净资产的情形），公司可分别要求公司领薪董事（不包括独立非执行董事）和高级管理人员按照预案执行稳定股价措施。但在任何情况下每一人单一年度用以稳定股价所动用的资金应不超过其上一年度从公司处领取的税后现金薪酬的 15%，超过上述标准的，该人士在当年度可不再继续实施稳定股价措施。但如下一年度出现触发本预案规定的稳定股价措施的情形时，将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

若公司在本次 A 股发行后三年内更换或聘任新的董事（独立非执行董事除外）、高级管理人员，在该等人员就任前，公司应要求其签署承诺书，保证其依照本预案的规定履行稳定股价的义务，并要求其依照公司本次 A 股发行时董事、高级管理人员出具的承诺提出未履行本预案项下义务时的约束措施。

公司违反上述承诺，将遵照另行出具的《Semiconductor Manufacturing International Corporation（中芯国际集成电路制造有限公司）关于未能履行相关承诺的约束措施的承诺函》承担相应责任。”

为保护投资者利益，公司就上述稳定股价措施作出承诺如下：

“公司将严格执行《Semiconductor Manufacturing International Corporation（中芯国际集成电路制造有限公司）关于首次公开发行人民币普通股（A 股）并在上海证券交易所科创板上市后三年稳定公司 A 股股价的预案》的相关规定。

如公司违反上述承诺，将遵照另行出具的《Semiconductor Manufacturing International Corporation（中芯国际集成电路制造有限公司）关于未能履行相关承诺的约束措施的承诺函》承担相应责任。

为保护投资者利益，公司领薪董事（不包括独立非执行董事）和高级管理人员就稳定股价措施作出如下承诺：”

“1、作为发行人的董事和/或高级管理人员，本人将依照《Semiconductor Manufacturing International Corporation（中芯国际集成电路制造有限公司）关于首次公开发行人民币普通股（A股）并在上海证券交易所科创板上市后三年稳定A股股价的预案》规定的条件等履行稳定公司A股股价的义务。

2、本人做出的承诺须符合适用法律、法规及规范性文件的规定，及证券监督管理部门和其他有权部门的监管要求。如本人违反上述承诺，将遵照另行出具的《Semiconductor Manufacturing International Corporation（中芯国际集成电路制造有限公司）董事、高级管理人员关于未能履行相关承诺的约束措施的承诺函》承担相应责任。”

二、股份回购和股份购回的措施和承诺

发行人出具股份回购和股份购回的承诺如下：

“1、如证券监督管理部门或其他有权部门认定公司本次A股发行的《招股说明书》所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，该等情形对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响，且以欺诈手段骗取发行注册并已经发行上市的，则公司承诺将依法回购本次A股发行的全部新股。

2、当《Semiconductor Manufacturing International Corporation（中芯国际集成电路制造有限公司）关于首次公开发行人民币普通股（A股）并在上海证券交易所科创板上市后三年稳定A股股价的预案》中约定的启动稳定股价的触发条件成就时，公司将按照此预案的规定履行回购公司股份的义务。

如公司违反上述承诺，将遵照另行出具的《Semiconductor Manufacturing International Corporation（中芯国际集成电路制造有限公司）关于未能履行相关承诺的约束措施的承诺函》承担相应责任。”

三、对欺诈发行上市的股份购回承诺

1、发行人出具欺诈发行上市的股份购回承诺如下：

“（1）保证公司本次 A 股发行不存在任何欺诈发行的情形。

（2）如公司不符合发行上市条件，以欺诈手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后的 5 个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次 A 股发行的全部新股。”

2、发行人主要股东大唐香港及鑫芯香港、间接持有发行人 5%以上股份的境内股东大唐控股及巽鑫投资出具欺诈发行上市的股份购回承诺如下：

“（1）保证发行人本次 A 股发行不存在任何欺诈发行的情形。

（2）如发行人不符合发行上市条件，以欺诈手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将督促发行人在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回发行人本次 A 股发行的全部新股。

如本公司未能依照上述承诺履行义务的，本公司将依照未能履行承诺时的约束措施承担相应责任。”

四、填补被摊薄即期回报的措施及承诺

本次公开发行完成后，随着募集资金的到位，公司的股本及净资产将大幅增长。但由于募集资金产生效益需要一定时间，短期内公司的营业收入和净利润难以实现同步增长，公司每股收益和净资产收益率等指标在发行后的一定期间内将会被摊薄。

1、发行人出具关于填补被摊薄即期回报的措施与承诺如下：

“（1）考虑到行业特性，公司将持续加大研发投入，积极拓展公司主营业务，增强持续盈利能力

本次 A 股发行完成后，公司资金实力增强，净资产规模扩大，资产负债率下降，从而提升了公司的抗风险能力和持续经营能力。在此基础上，公司将通过募集资金投资项目大力拓展主营业务，扩大市场份额，增强公司持续盈利能力，提高股东回报。

(2) 不断完善公司治理，加强公司内部控制建设，为公司发展提供制度保障

公司将不断完善公司治理结构，努力加强内部控制建设，继续完善并优化经营管理和投资决策程序，提高日常经营效率，确保股东能够充分行使权力，确保董事会能够按照法律、法规和《Semiconductor Manufacturing International Corporation（中芯国际集成电路制造有限公司）组织章程大纲及章程细则》的规定行使职权、做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立非执行董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是公众股东的合法权益。

(3) 推进募投项目建设进度，提高资金使用效率

公司募集资金投资项目围绕公司主营业务，经过论证，符合公司发展战略和国家产业政策，具有良好的市场前景和经济效益。本次募集资金到位后，公司将继续推进募投项目的投资与建设进度，同时将严格执行公司募集资金管理制度，加强对募集资金的管理，确保专款专用，防范募集资金使用风险，保障投资者的利益。

(4) 完善利润分配政策，优化投资回报机制

公司将制定《Semiconductor Manufacturing International Corporation（中芯国际集成电路制造有限公司）利润分配政策及首次公开发行人民币普通股（A股）并在上海证券交易所科创板上市后三年分红回报计划》。本次A股发行完成后，公司将严格执行前述文件的相关规定，结合公司经营情况和发展规划，在符合条件的情况下积极推动对投资人的利润分配及现金分红，努力提升股东回报。

如公司违反上述承诺，将遵照另行出具的《Semiconductor Manufacturing International Corporation（中芯国际集成电路制造有限公司）关于未能履行相关承诺的约束措施的承诺函》承担相应责任，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。”

2、发行人董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的措施与承诺如下：

“(1) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

(2) 本人承诺对职务消费行为进行约束。

(3) 本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

(4) 本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与发行人填补被摊薄即期回报的措施的执行情况相挂钩。

(5) 如发行人后续推出股权激励政策，本人承诺同意拟公布实施的发行人股权激励的行权条件与发行人填补被摊薄即期回报的措施的执行情况相挂钩。

(6) 自本承诺出具日至发行人本次 A 股发行完毕前，如中国证券监督管理委员会或上海证券交易所发布关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足前述规定时，本人承诺届时将按照前述规定出具补充承诺。

(7) 本人承诺切实履行发行人制定的有关填补被摊薄即期回报的措施以及对此做出的任何有关填补被摊薄即期回报的措施的承诺，如违反该等承诺并给发行人或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对发行人或者投资者的补偿责任。

本人做出的承诺须符合适用法律、法规及规范性文件的规定，及证券监督管理部门和其他有权部门的监管要求。如本人违反上述承诺，将遵照另行出具的《Semiconductor Manufacturing International Corporation（中芯国际集成电路制造有限公司）董事、高级管理人员关于未能履行相关承诺的约束措施的承诺函》承担相应责任。”

五、利润分配政策的承诺

本次发行完成后，发行人将严格按照关于利润分配政策及《有关利润分配政策及人民币股份发行后三年的股息回报计划之决议案》的相关规定执行股利分配政策，其中载明的股利分配政策参见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、公司本次发行后的股利分配政策和决策程序”。

发行人关于利润分配政策的承诺如下：

“公司在本次 A 股发行后将严格依照中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《Semiconductor Manufacturing International Corporation（中芯国际集成电路制造有限公司）组织章程大纲及章程细则》及《Semiconductor Manufacturing International Corporation（中芯国际集成电路制造有限公司）利润分配政策及首次公开发行人民币普通股（A 股）并在上海证券交易所科创板上市后三年分红回报计划》等规定执行利润分配政策。

如公司违反上述承诺，将遵照另行出具的《Semiconductor Manufacturing International Corporation（中芯国际集成电路制造有限公司）关于未能履行相关承诺的约束措施的承诺函》承担相应责任。”

六、依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺

1、发行人关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺如下：

“如《招股说明书》及其他信息披露资料所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，则公司将依法赔偿投资者损失。”

2、发行人主要股东大唐香港及鑫芯香港关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺如下：

“如《招股说明书》及其他信息披露资料所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，则本公司将依法赔偿投资者损失。”

3、发行人间接持有发行人 5%以上股份的境内股东大唐控股及巽鑫投资关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺如下：

“如《招股说明书》及其他信息披露资料所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，则本公司将依法赔偿投资者损失。”

4、发行人董事、高级管理人员关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺如下：

“如《招股说明书》及其他信息披露资料所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，则本人将依法赔偿投资者损失。”

5、联席保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司承诺如下：

“因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。”

6、联席主承销商国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国开证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司承诺如下：

“因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。”

七、未履行承诺的约束措施

1、针对本次 A 股发行过程中所做出的各项承诺之履行事宜，发行人承诺如下：

“（1）公司在本次 A 股发行中做出的全部公开承诺（以下简称“承诺事项”）均为公司的真实意思表示，并对公司具有约束力，公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督。公司将严格履行承诺事项中的各项义务和责任。

（2）如公司非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行承诺事项，则公司承诺将采取以下措施予以约束：

①可以采取相应补救措施或提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规及规范性文件、《Semiconductor Manufacturing International Corporation（中芯国际集成电路制造有限公司）组织章程大纲及章程细则》及相关内控制度的规定履行相关审批和信息披露程序）；

②在证券监管管理部门或其他有权部门认定公司违反或者未实际履行承诺事项之日起 30 日内,或认定因公司违反或未实际履行承诺事项而致使投资者在证券交易中遭受损失之日起 30 日内,公司将依法向投资者赔偿相应损失,补偿金额依据公司与投资者协商确定的金额,或证券监督管理部门或其他有权部门认定的方式或金额确定。”

2、发行人全体董事、高级管理人员承诺如下:

“(1)本人在发行人本次 A 股发行中做出的全部公开承诺(以下简称“承诺事项”)均为本人的真实意思表示,并对本人具有约束力,本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督。本人将严格履行承诺事项中的各项义务和责任。

(2)如本人非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行承诺事项,则本人承诺将采取以下各项措施予以约束:

①可以采取相应补救措施或提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、规范性文件及《Semiconductor Manufacturing International Corporation(中芯国际集成电路制造有限公司)组织章程大纲及章程细则》、相关内控制度的规定履行相关审批和信息披露程序);

②在证券监管部门或其他有权部门认定本人违反或者未实际履行前述承诺事项之日起 30 日内,或认定因本人违反或未实际履行承诺事项而致使投资者在证券交易中遭受损失之日起 30 日内,本人自愿将从发行人所领取的全部薪酬和/或津贴对投资者先行进行赔偿。”

3、发行人主要股东大唐香港及鑫芯香港、间接持有发行人 5%以上股份的境内股东大唐控股及巽鑫投资承诺如下:

“(1)本公司在发行人本次 A 股发行中做出的全部公开承诺(以下简称“承诺事项”)均为本公司的真实意思表示,并对本公司具有约束力,本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督。本公司将严格履行承诺事项中的各项义务和责任。

(2)如本公司非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行前述承诺事项,则本公司承诺将采取以下各项措施予以约束:

①可以采取相应补救措施或提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、规范性文件及公司章程、相关内控制度的规定履行相关审批和信息披露程序）；

②在证券监管部门或司法机关最终认定本公司违反或者未实际履行前述承诺事项且应承担赔偿责任的，本公司将依法承担相应赔偿责任。”

八、关于减少并规范关联交易的承诺

1、发行人主要股东大唐香港及鑫芯香港、间接持有发行人 5%以上股份的境内股东大唐控股及巽鑫投资承诺如下：

“（1）在不对发行人及其他股东的利益构成不利影响的前提下，本公司将采取措施规范并尽量减少与发行人发生关联交易。

（2）对于正常经营范围内所需的关联交易，本公司将与发行人依法签订规范的交易协议，并按照有关法律、法规、规范性文件和发行人本次 A 股发行后适用的《Semiconductor Manufacturing International Corporation（中芯国际集成电路制造有限公司）组织章程大纲及章程细则》等发行人内控制度的规定履行或配合发行人履行审议批准程序和回避表决及信息披露义务，并保证该等关联交易均将基于公平公正公开等关联交易基本原则实施。

（3）保证不利用关联交易损害发行人及其他股东的利益。

如本公司未能依照上述承诺履行义务的，本公司将依照未能履行承诺时的约束措施承担相应责任。”

2、发行人董事、高级管理人员承诺如下：

“（1）在不对发行人及其他股东的利益构成不利影响的前提下，本人将采取措施规范并尽量减少与发行人发生关联（连）交易。

（2）对于正常经营范围内或存在其他合理原因无法避免的关联（连）交易，本人将与发行人依法签订规范的交易协议，并按照有关法律、法规、规范性文件和发行人本次 A 股发行后适用的《Semiconductor Manufacturing International Corporation（中芯国际集成电路制造有限公司）组织章程大纲及章程细则》及相

关内控制度的规定履行审议批准程序和回避表决及信息披露义务，并保证该等关联（连）交易均将基于关联（连）交易原则实施。

(3) 保证不利用关联（连）交易损害发行人及其他股东的利益。

本人做出的承诺须符合适用法律、法规及规范性文件的规定，及证券监督管理部门和其他有权部门的监管要求。如本人违反上述承诺，将遵照另行出具的《Semiconductor Manufacturing International Corporation（中芯国际集成电路制造有限公司）董事、高级管理人员关于未能履行相关承诺的约束措施的承诺函》承担相应责任。”

九、关于避免同业竞争的承诺

1、发行人主要股东大唐香港及鑫芯香港、间接持有发行人 5%以上股份的境内股东大唐控股及巽鑫投资承诺如下：

“（1）截至本承诺函出具之日，本企业及本企业直接或间接控制的下属企业并未在中国境内或境外以任何方式直接或间接从事与发行人或其下属企业主营业务存在同业竞争或潜在同业竞争的业务，包括但不限于未单独或连同、代表任何人士、商号或公司（企业、单位），发展、经营或协助经营、参与、从事相关业务。

（2）自本承诺函出具之日起，本企业承诺将不会：（1）单独或与第三方，以直接或间接控制的形式从事与发行人或其下属企业主营业务构成具有重大不利影响的同业竞争或潜在同业竞争的业务或活动（以下简称“竞争业务”）；（2）如本企业及本企业直接或间接控制的下属企业获得以任何方式拥有与发行人及其下属企业从事竞争业务企业的控制性股份、股权或权益的新投资机会，本企业将书面通知发行人，若在通知中所指定的合理期间内，发行人做出愿意接受该新投资机会的书面答复，本企业或本企业直接或间接控制的下属企业（发行人及其下属企业除外）在合法框架下尽力促使该等新投资机会按合理和公平的条款和条件首先提供给发行人或其下属企业。

（3）本承诺函自出具之日起生效，直至发生下列情形之一时终止：（1）本企业及一致行动人（如有）直接或间接持有发行人股份比例低于 5%（不包括本

数)；(2) 发行人的股票终止在上海证券交易所上市(但发行人的股票因任何原因暂停买卖除外)；(3) 国家规定对某项承诺的内容无要求时，相应部分自行终止。

(4) ‘下属企业’就本承诺函的任何一方而言，指由其(1) 持有或控制 50%或以上已发行的股本或享有 50%或以上的投票权(如适用)，或(2) 有权享有 50%或以上的税后利润，或(3) 有权控制董事会之组成或以其他形式控制的任何其他企业或实体(无论是否具有法人资格)，以及该其他企业或实体的下属企业。”

十、关于适用法律和管辖法院的承诺

发行人出具关于适用法律和管辖法院的承诺如下：

“1、若因公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在上海证券交易所科创板上市以及公司在科创板上市期间所发生的纠纷，将适用中华人民共和国(不包含香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)(简称“中国”)法律，并由中国境内有管辖权的人民法院管辖。公司不会对上述法律适用及法院管辖提出异议。

2、前述第1条规定的‘纠纷’应包括：(1) 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律法规或者公司章程的规定给公司造成损失的，或者他人侵犯公司合法权益给公司造成损失的，连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上人民币普通股(A股)的股东提起的派生诉讼；(2) 因公司未按照规定披露信息，或者公告的证券发行文件、定期报告、临时报告及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使人民币普通股(A股)股东在证券交易中遭受损失的，人民币普通股(A股)的股东针对发行人及其他相关责任人提起的民事赔偿诉讼。”

发行人全体董事、高级管理人员承诺如下：

“1、若本次A股发行上市以及在科创板上市期间发生纠纷，将适用中华人民共和国(不包含香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)(简称“中国”)法律，并由中国境内有管辖权的人民法院管辖。

2、本人不会对上述法律适用及法院管辖提出异议。”

十一、证券服务机构对于虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺

1、联席保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司承诺如下：

“因本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。”

2、联席主承销商国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国开证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司承诺如下：

“因本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。”

3、发行人律师上海市锦天城律师事务所承诺如下：

“本事务所为发行人首次公开发行 A 股股票并上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。若因本事务所为发行人首次公开发行 A 股股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，且本所因此应承担赔偿责任的，本事务所将依法赔偿投资者损失。”

4、审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）承诺如下：

“本所确认，对本所出具报告的真实性、准确性和完整性依据有关法律法规的规定承担相应的法律责任，包括如果本所出具的上述报告有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。”

十二、保荐机构、发行人律师对发行人及相关责任主体承诺的核查意见

经核查，联席保荐机构认为，发行人、发行人的主要股东、董事及高级管理人员已经按照《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》以及监管部门的要求出具了相关承诺。在承诺中，承诺人就其未能履行在本次发行中作出的承诺提出了对应的约束措施。上述承诺内容合法、合规，约束措施合理并具有可操作性，有利于保护上市公司及中小股东的利益。承诺人出具上述承诺已经履行了相关决策程序，并已经相关责任主体或其授权代表签署、盖章，符合《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》及相关文件对责任主体作出公开承诺应同时提出未履行承诺时的约束措施的相关要求。

经核查，发行人律师认为，相关主体作出的承诺内容符合法律、法规和规范性文件的规定以及中国证监会、上海证券交易所的要求，相关承诺主体提出的违反承诺时可采取的约束措施合法，不违反法律、法规的强制性或禁止性规定。

（本页无正文，为《中芯国际集成电路制造有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》之盖章页）

中芯国际集成电路制造有限公司
2020年7月15日

A red circular stamp is positioned to the left of the company name and date. The stamp contains the text "Semiconductor Manufacturing International Corporation" in English around the top inner edge and "中芯国际集成电路制造有限公司" in Chinese around the bottom inner edge. The center of the stamp features a stylized logo.

（本页无正文，为《中芯国际集成电路制造有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》之盖章页）



（本页无正文，为《中芯国际集成电路制造有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》之盖章页）



（本页无正文，为《中芯国际集成电路制造有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》之盖章页）



国泰君安证券股份有限公司

2020年7月15日

（本页无正文，为《中芯国际集成电路制造有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》之盖章页）



(本页无正文，为《中芯国际集成电路制造有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》之盖章页)



（本页无正文，为《中芯国际集成电路制造有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》之盖章页）

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司



2020年7月15日